

CUTTING EDGE

カッティングエッジ

76期中間事業のご報告

平成26年4月1日～平成26年9月30日



社長メッセージ



**売上高・利益は、ともに半期ベースでは過去最高を更新し、
経常利益率は、2007年度上期以来となる20%台に回復いたしました。**

事業環境・業績

2014年度上期においては、スマートフォンの幅広い機種で売れ行きが好調だったことから、顧客である半導体・電子部品メーカー各社が積極的な設備投資活動を行いました。このような市場動向に加え、LED関連需要の活発化が追い風となり、当社主力製品であるブレードダイサの販売は前年同期から急伸びいたしました。また、消耗品である精密加工ツールの売上も非常に高い水準で推移しました。損益については、積極的な販売活動や研究開発活動により販売管理費が増加したものの、売上高の増加や製品構成の変化・為替の影響などにより、収益性は大きく改善いたしました。

以上の結果、売上高・利益は、ともに半期ベースでは過去最高を更新し、経常利益率は2007年度上期以来となる20%台に回復いたしました。中間配当

金につきましては前年同期から22円増配となる1株当たり72円とさせていただきます。

今後の見通し

2008年9月のリーマン・ショック以降、主にスマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器がけん引役となり、半導体市場は拡大基調にあります。これらの最終製品は、いわゆるクリスマス商戦をターゲットとして1年という短いモデルチェンジサイクルを繰り返しており、搭載される半導体・電子部品の生産も短期間で大量に行われる必要が出てきています。近年では、そのニーズに対応すべくアジア地域のメーカー各社が、ビジネスモデルを従来の垂直統合型から水平分業型にシフトさせ、『上期に積極的な設備投資、下期に調整』という傾向を強めています。当社の売上高推移は、この顧客動向に倣う動きとなっており、

2014年度においてもこのトレンドが継続するものと思われませんが、一方でLEDをはじめとする複数のアプリケーションが台頭してきたことにより、下期売上高の減少は例年に比べて緩やかなものになると見込んでおります。

2015年1月には当社製品の生産拠点である桑畑工場(広島県呉市)に免震構造の新棟が竣工する予定となっております。来年度以降も拡大し続けることが予想される半導体・電子部品需要に対応すべく、生産体制の増強・BCM対応力の向上を実現してまいります。

株主の皆様におかれましては今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

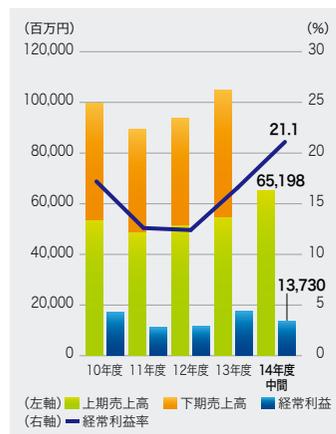
※BCM : Business Continuity Management/事業継続管理

2014年12月
代表取締役社長 関家一馬

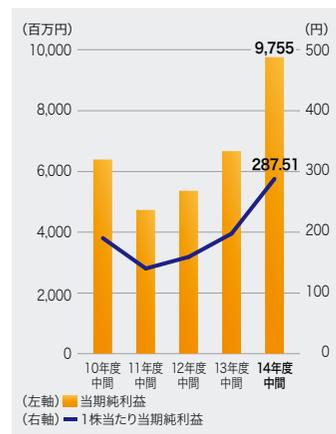


財務ハイライト

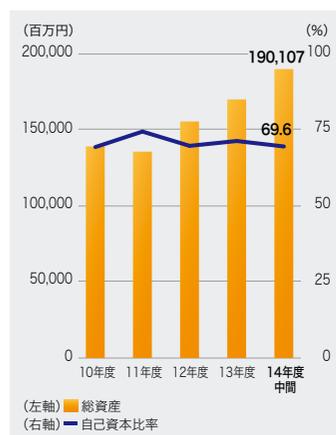
売上高・経常利益・経常利益率



当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2014年4月1日から2014年9月30日まで)では、スマートフォンのローエンドモデルが数的な拡大を続ける一方、ハイエンドモデルがメモリ容量を増大させるなどしたため、半導体・電子部品メーカー各社は設備投資を積極的に実施しました。特に量産拠点が集中する台湾や中国などアジア地域からの需要が強く、また、モジュール化などにより付加価値を高めた電子部品などを手がける国内メーカーからの引き合いが底堅く推移しました。さらに、先進国向け照明用LEDの品質向上を背景に、量産性と安定性を両立させる当社製品が選ばれるようになったことから、当期の売上高は半期としては過去最高となりました。

以上の結果、当期の業績は前期から増収増益となる、売上高651億98百万円(前年同期比19.4%増)、営業利益137億24百万円(前年同期比40.0%増)、経常利益137億30百万円(前年同期比40.8%増)、純利益97億55百万円(前年同期比46.4%増)となりました。

■財政状態

当期末の総資産は、前期末と比べ199億46百万円増加し、1,901億7百万円となりました。これは、主に売上高の増加に伴い現預金や売上債権が増加したことによるものです。

負債は、前期末と比べ90億13百万円増加し、557億18百万円となりました。純資産は、前期末から109億

32百万円増加し1,343億89百万円となり、自己資本比率は前期末比1.8ポイント減の69.6%となりました。

■キャッシュ・フロー

営業活動では140億88百万円の資金増加、投資活動では40億39百万円の資金減少だったことからフリー・キャッシュ・フローは100億49百万円の資金増加となりました。これは、投資活動において桑畑工場新棟の建設での資金支出があった一方、営業活動により大幅に資金増加したためです。財務活動では、主に配当金の支払によって19億22百万円の資金減少となりました。

これらの結果、当期末の資金残高は303億3百万円となりました。

通期の連結業績予想

スマートフォンを中心にモバイル関連需要が、引き続き底堅く推移することが見込まれるため、売上高は前回(8月)発表の予測値に対し4.9%増加し、利益は過去最高を更新する予定です。この結果、3期連続の増収増益を予想していることから、当期純利益の25%を充当させる配当金については、1株当たり127円(中間実績72円、期末予想55円)を見込んでおります。

2015年3月期

(金額の単位：百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
119,500	23,200	23,400	17,200	504.92円



ディスコの企業理念



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評価されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができていくか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。